

【公報種別】特許法第17条の2の規定による補正の掲載

【部門区分】第7部門第2区分

【発行日】平成17年11月17日(2005.11.17)

【公開番号】特開2001-189375(P2001-189375A)

【公開日】平成13年7月10日(2001.7.10)

【出願番号】特願2000-318560(P2000-318560)

【国際特許分類第7版】

H 01 L 21/68

C 23 C 16/46

H 01 L 21/205

H 01 L 21/3065

H 01 L 21/31

H 01 L 21/324

【F I】

H 01 L 21/68 N

C 23 C 16/46

H 01 L 21/205

H 01 L 21/31 E

H 01 L 21/324 Q

H 01 L 21/302 B

【手続補正書】

【提出日】平成17年9月30日(2005.9.30)

【手続補正1】

【補正対象書類名】明細書

【補正対象項目名】特許請求の範囲

【補正方法】変更

【補正の内容】

【特許請求の範囲】

【請求項1】加熱手段と、基板を支持する基板支持手段とを備える基板処理装置であって、

前記基板支持手段は、前記基板支持手段に対して前記加熱手段と反対側で前記基板を支持し、

前記基板支持手段は石英材を備え、前記石英材の少なくとも一部に前記加熱手段からの光子エネルギーが伝達されるのを阻止する阻止部を設けたことを特徴とする基板処理装置。

【請求項2】前記基板支持手段は、第1および第2の部材を備え、

前記第1の部材は、前記基板を支持する第1の支持面を有し、

前記第2の部材は、前記第1の部材を支持する第2の支持面を有し、

前記第2の部材は、中央部に開口を有し、

前記第2の支持面は、前記開口の周りに設けられ、

前記第1の部材は、前記開口を覆って前記第2の部材の前記第2の支持面で支持されることを特徴とする請求項1記載の基板処理装置。

【請求項3】加熱手段と、基板を支持する基板支持手段と、前記基板支持手段を前記加熱手段上で支持する前記基板支持手段の支持手段とを備える基板処理装置であって、

前記基板支持手段が、前記基板を支持する第1の支持面を備える第1の部材と

、前記第1の部材を支持する第2の支持面を備える第2の部材とを備え、

前記第1および第2の部材の少なくとも一つが石英材を備え、前記石英材の少なくとも一部に前記加熱手段からの光子エネルギーが伝達されるのを阻止する阻止部を設けたことを特徴とする基板処理装置。

【請求項 4】前記第 2 の部材は石英材を備え、

前記第 2 の部材は、前記第 2 の支持面の周りに設けられた周辺部を備え、前記第 2 の部材の前記石英材の少なくとも前記周辺部に前記阻止部が設けられていることを特徴とする請求項 3 記載の基板処理装置。

【請求項 5】加熱手段と、基板を支持する基板支持手段とを備える基板処理装置であって、

前記基板支持手段は、前記基板支持手段に対して前記加熱手段と反対側で前記基板を支持し、

前記基板支持手段は、中央の開口と、前記中央の開口の周りに設けられた前記基板を支持する支持面とを有する支持部材を備え、

前記支持部材は、石英材を備え、前記石英材のすくなくとも一部は不透明となっており、前記支持面は窪んで設けられ、前記窪んだ支持面は、その上に前記基板を支持し、前記基板の熱膨張を制限しないような大きさに構成されていることを特徴とする基板処理装置。